

2018年8月28日

各 位

電子部品焼成用セラミックストレー「セラメッシュ™」を開発

～焼成製品の歩留まり向上に期待。60%の軽量化により熱量軽減で省エネにも貢献～

当社（社長 西田計治）は、MLCC^{*1}などの電子部品焼成用次世代セラミックストレー「セラメッシュ™」の量産出荷をはじめましたので、お知らせいたします。

当社セラミックス事業部（福岡県大牟田市）のセラミックス製品は、軽量化、薄型化、高強度化、複雑形状化等のお客様のご要望にこたえた製品を提供しており、電子部品焼成用窯道具として広く採用されております。

昨今、スマートフォンに加え、IoT化、自動車のADAS^{*2}等による電装化により電子部品の需要が旺盛な中、当社は電子部品焼成用窯道具のトップメーカーとして需要に対応すべく、順次増産と新製品開発を進めておりますが、この度、次世代セラミックストレーとして網目状のセラミック基板「セラメッシュ™」を開発しました。網目状にすることによって、セラミック板上の被焼成物から発生するガスの抜け性や被焼成物付近の雰囲気ガスの循環が良くなる為、脱脂や温度分布がより均一となり、製品歩留まりの向上が期待されます。また、通常の板に比べて60%の軽量化が可能となり、窯道具板を加熱するための熱量が軽減できる為、熱追随性の向上と省エネにも貢献できます。

本開発品は、既に少量生産ラインを立ち上げ済みであり、今後は、需要に応じて増強を行う予定です。

当社のスローガンである「マテリアルの知恵を活かす」のもと、お客様への安定した品質と十分な供給を確保すると共に、更に改良を進め、お客様の製品歩留まり、生産性の向上、省エネに貢献してまいります。

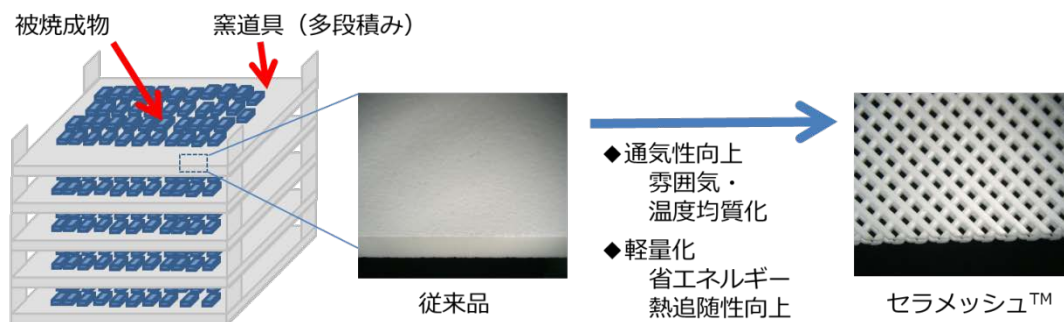
以 上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 広報部 TEL 03-5437-8028 FAX 03-5437-8029

Eメール PR@mitsui-kinzoku.com

(参考)



■多様な無機材質で提供可能

例) Al_2O_3 、 ZrO_2 、 SiC 、 Si_3N_4 、ムライト、コージェライト等

■大幅な軽量化が可能

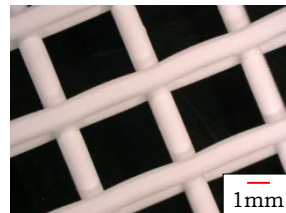
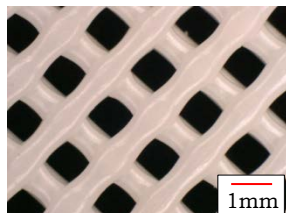
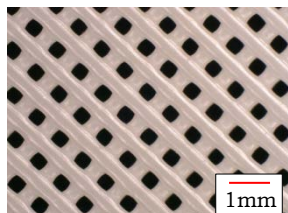
例) $\square 100 \times 2\text{mm}$ のアルミナ磁器の場合、60%の軽量化が可能。

従来品 : 75 g \Rightarrow セラメッシュ™ (線径 1mm) : 30g

■幅広いレンジで微細・粗大なメッシュ目開き/線径/形状で提供可能

例) 目開きは 0.2~3.0 mm、線径は 0.3~1.6mm が可能。

縦横最大 300 mm サイズで様々な形状で提供可能。



補足)

※1 MLCC … 積層セラミックコンデンサ、「Multi-Layer Ceramic Capacitor」の略

※2 ADAS … 先進運転支援システム、「Advanced Driver Assistance System」の略